

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



DIN导轨壳体，带金属脚扣的下部壳体，带通风栅，宽度: 18.9 mm，高度: 120.6 mm，深度: 64.3 mm，颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)，交叉连接: DIN导轨总线连接器（可选），横向连接器的位置编号: 5 或 8

优势

- 无需工具即可轻松安装
- 可选的DIN导轨总线连接器，轻松实现模块间通信
- 锁紧&释放原理，用于自动锁定和直观释放正面连接插头
- 塑料符合UL94 V0标准：适合更严格的可燃性要求
- 更高的灵活性：与采用DIN导轨连接器的ICS系列电子模块壳体组合使用

商业数据

订货号	2202506
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ACHEBA
产品关键代码	ACHEBA
GTIN	4055626199207
单件重量（含包装）	36.94 g
单件重量（不含包装）	32.82 g
原产地	DE

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体

2202506

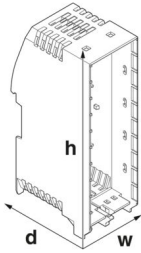
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2202506>



技术数据

说明	
组装说明	请参阅下载区内的应用说明。
推荐	总线连接器接触片的材料，电镀金（硬金）

产品属性	
产品类型	外壳的下部
外壳类型	DIN导轨壳体
壳体系列	ME-IO
最大位数	48 (针距: 3.45 mm)
	32 (针距: 5 mm)
型号	带金属脚扣的下部壳体
带通风口	是

尺寸	
尺寸图	
宽度	18.9 mm
高度	120.6 mm
深度	64.3 mm
从DIN导轨顶部边缘起的深度	57.7 mm

PCB设计	
PCB板厚度	1.4 mm ... 1.8 mm

材料规格	
颜色 (外壳)	浅灰 (RAL 7035)
阻燃等级，符合UL 94	V0
CTI符合IEC 60112	600
外壳材料	PA
表面特性	未处理

环境和真实条件	
功耗 单壳体 用于 20 °C	
环境温度	20 °C
降低因数	1

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体



2202506

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2202506>

安装位置	垂直
功耗	9.2 W

功耗 单壳体 用于 30 °C

环境温度	30 °C
降低因数	0.81
安装位置	垂直
功耗	7.5 W

功耗 单壳体 用于 40 °C

环境温度	40 °C
降低因数	0.63
安装位置	垂直
功耗	5.8 W

功耗 单壳体 用于 50 °C

环境温度	50 °C
降低因数	0.46
安装位置	垂直
功耗	4.3 W

功耗 单壳体 用于 60 °C

环境温度	60 °C
降低因数	0.31
安装位置	垂直
功耗	2.9 W

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz)
加速度	2g (58.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

灼热线测试

规格	IEC 60695-2-11:2014-02
温度	850 °C
暴露时间	30 s

热稳定性/滚珠测试

规格	IEC 60695-10-2:2014-02
温度	125 °C
测试持续时间	1 h
力	20 N

机械强度/滚桶

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体



2202506

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2202506>

规格	IEC 60068-2-31:2008-05
下降高度	50 cm
频率	50

冲击

规格	IEC 60068-2-27:2008-02
脉冲波形	半正弦
加速度	15g
电击时间	11 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

规格	VDMA 24364:2018-05
----	--------------------

防护等级 (IP代码)

规格	IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08
----	---

环境条件

要达到的最大IP编码	IP20
环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 55 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C
相对湿度 (存放/运输)	80 %

PCB数据

PCB支架数量	1
PCB安装类型	锁扣
总PCB表面	6500 mm ²
PCB厚度	1.4 mm ... 1.8 mm

安装

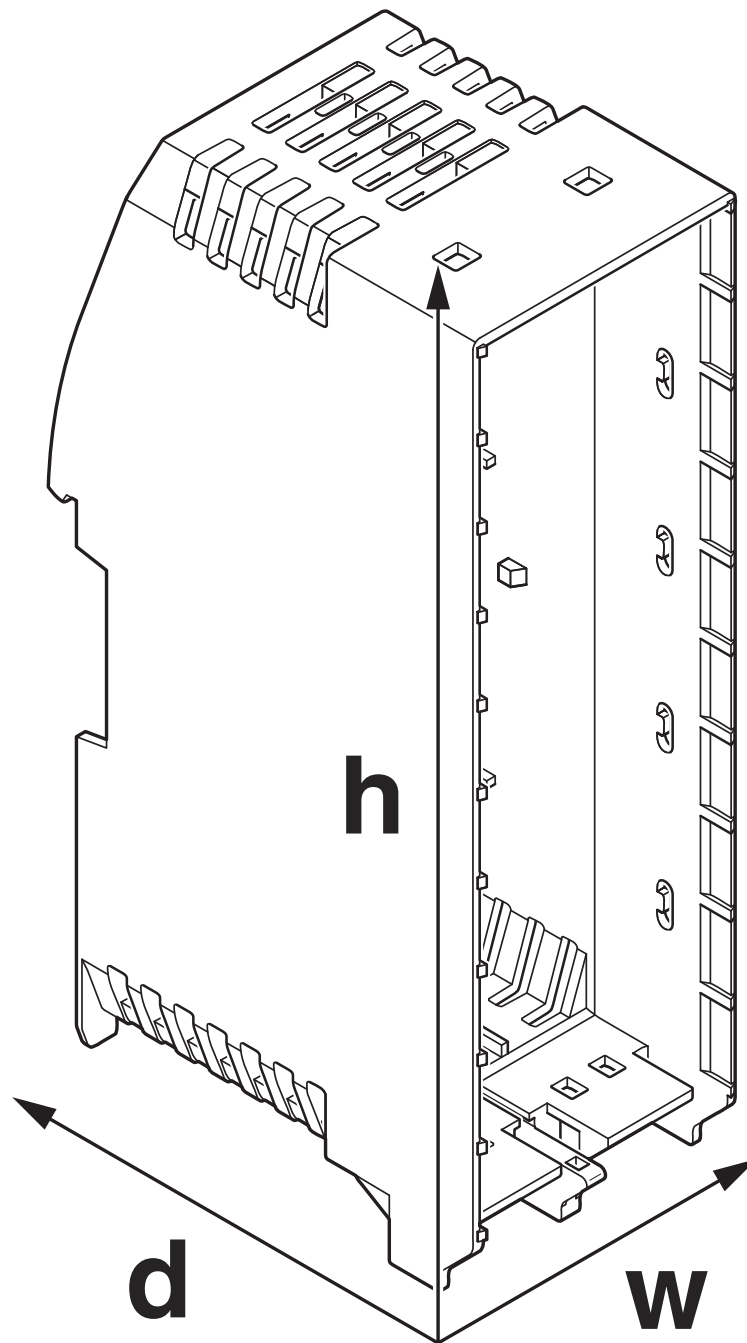
安装类型	DIN导轨安装
------	---------

包装规格

包装类型	纸箱包装
外包装类型	纸箱

图纸

尺寸图



用于展示产品项目尺寸的示意图。图中并不是所需的产品。详细信息请见“下载”选项卡下的产品图示。

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体



2202506

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2202506>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2202506>



UL认证

认证ID: E240868

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体



2202506

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2202506>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%